

## 2024年度 貨物等省令等に係る改正（R6.7.8 公布）説明会（FAQ）

No.	政令項番	質 問	回 答
1	<p>【7項：貨物】</p> <p>貨物等省令 第6条第一号 カ</p>	<p>貨物等省令第6条第一号カ：相補型金属酸化膜半導体集積回路であって、零下268.65度以下の温度で作動するように設計したもの（ロに該当するものを除く。）の新設に伴う今後の対応について、下記の認識で合っているかどうかについてご教示ください。</p> <p>①専用集積回路として判定する集積回路については、「他の装置」の項で判定するとともに、貨物等省令第6条第一号カでも判定を行う必要がある。</p> <p>②省令第6条第一号ロに記述されていない集積回路については、それぞれの項番に対応した判定を行うとともに、貨物等省令第6条第一号カでも判定を行う必要がある。</p> <p>③省令第6条第一号ロに記述された集積回路については、従来どおり当該項番で動作温度の確認を行うため、貨物等省令第6条第一号カでの判定は不要である。</p>	<p>①②ご理解のとおりです。</p> <p>③ロに該当する集積回路は、「カ」から除外されていますので、「ロ」に該当する場合には判定不要となります。</p>
2	<p>【7項：貨物】</p> <p>貨物等省令 第6条第一号 カ</p>	<p>「貨物等省令第6条第一号カに規定する相補型金属酸化膜半導体集積回路」の解釈で「極低温CMOS又はクライオCMOSともいう。」と規定されています。</p> <p>この「貨物等省令第6条第一号カに規定する相補型金属酸化膜半導体集積回路」は貨物等省令第6条第一号1カに該当する集積回路という意味、つまり、「極低温CMOS又はクライオCMOS」は該当品を意味する文言でしょうか。</p> <p>それとも、「貨物等省令第6条第一号カに規定する相補型金属酸化膜半導体集積回路」という意味でしょうか？</p> <p>と言いますのは、上記解釈において「・・・に規定する・・・」との表現が使用されていることから読み方に疑問が生じているためです。</p> <p>該非に言及することなく文言の説明となっている他の「解釈」においては、次の様に「・・・中の・・・」との表現となっております。</p> <p>(解釈)</p> <p>・貨物等省令第6条第一号ホ（一）中のアナログデジタル変換用のもの：“貨物等省令第6条第一号ホ（一）中のアナログデジタル変換用のもの（以下、「ADC」という。）</p>	<p>「貨物等省令第6条第一号カに規定する相補型金属酸化膜半導体集積回路」とは、貨物等省令第6条第一号1カに該当する集積回路という意味です。</p>

No.	政令項番	質 問	回 答
		<p>については、以下のとおりとする。(以下、略)</p> <p>・貨物等省令第6条第一号ワ(一)中のアナログデジタル変換機能を有するもの：“貨物等省令第6条第一号ワ(一)中のアナログデジタル変換機能を有するものについては、以下のとおりとする。(以下、略)</p> <p>他の「解釈」とは異なり、わざわざ別の表現がされているということは異なる意味を示している、つまり、「省6-1カに該当する集積回路」と読むべきと判断する者が現れております。</p> <p>次に示します原文(Technical Note)が当該「解釈」に当たる部分と見受けませんが、「規制の目的上、CMOSとは極低温CMOSと呼ばれるもの」と読めますので、該当品を指す「解釈」ではないと考えておりますが、如何でしょうか。</p> <p>Technical Note For the purposes of 3.A.1.a.15.,CMOS integrated circuits are also referred to as cryogenic CMOS or cryo CMOS.</p>	
3	<p>【7項：技術】</p> <p>貨物等省令第19条第3項第八号</p>	<p>「必要な技術」の対象範囲に関して確認させてください。(パブリックコメント案件595124053のNo5の意見と回答を読みましたが、スッキリとはしなかったものの質問です。)</p> <p>*外為令別表：7の項(3)集積回路の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((1)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)とあって、貨物等省令第19条第3項の経済産業省令で定めるもの第八号 ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET)の構造を有する集積回路又は半導体素子の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、...とあるので、</p> <p>質問1)</p> <p>本件での「必要な技術」とは「GAAFETの構造を有するもの」と「それを有さない構造のもの」とに差のついての設計又は製造に関する技術の事を指すとの理解で良いか(具体的に言えばGAAFET構造のその部分を成立させるための必要な技術)。</p>	<p>1) 2)「必要な技術」とは、規制の性能レベル、特性もしくは機能に到達し又はこれらを超えるために必要な技術を意味しますので、当該解釈により個別に判定をお願いします。</p>

No.	政令項番	質 問	回 答
		<p>質問2)</p> <p>今後、GAAFET の構造を有するものが主流になった時に、GAAFET 構造をもつものの中でも性能向上を目指して必要な技術は行われていくが、その時、GAAFET を持たない構造のものへの適用は考慮されないために、その技術が①における必要な技術かどうか必ずしも明確ではない。あくまでも原理的な技術的判断で対応することに支障はあるか。</p> <p>それとも、「GAAFET の構造を有するものの設計又は製造に必要な技術」として GAAFET 構造の世代向けの技術は全て①での必要な技術と理解すべきか。(GAAFET 部分に直接は無関係な技術や既存技術もこの必要な技術として該当となる場合が発生してくる)。</p> <p>質問3)</p> <p>特に上記(2)の後半の場合、「【7の項】(3)」で該当となると同時に「【7の項】」の(3)以外でも該当する技術と判断される場合が考えられるが、その場合、包括許可取扱の区分が異なるがその両方で対応するのか。(③は特定、③以外は特別一般。)</p>	<p>3)両方の包括マトリクスを満たす必要があります。</p>
4	【7項：技術】 貨物等省令第19条第3項第八号	<p>新設の『外為令別表の7の項(3)、貨物等省令第19条第3項第八号：ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET)の構造を有する集積回路又は半導体素子の設計又は製造に必要な技術』において、GAAFET 構造を直接製造するための半導体レジスト材料技術ではないが、GAAFET 構造を有する集積回路又は半導体素子の GAAFET 構造以外の半導体を製造する半導体レジスト材料技術も該当技術となるのでしょうか？</p>	<p>当該技術が、GAAFET 構造を有する集積回路又は半導体素子の設計又は製造に必要な技術にあたるか否かで個別に判定をお願いします。</p>
5	【7項：技術】 貨物等省令第19条第3項第八号	<p>役務通達の解釈「プロセスレシピ(特定のプロセスステップのための一連の条件及びパラメータをいう。)を含む。」の具体例を複数ご教示ください。</p>	<p>プロセスレシピとは、特定のプロセスステップのための一連の条件及びパラメータをいいます。</p> <p>具体例につきましては、上記解釈に基づいて、個別にご判断ください。</p>
6	【7項：技術】 貨物等省令第19条第3	<p>●「貨物等省令第19条第3項第八号に規定するツール」の解釈について</p> <p>「貨物等省令第19条第3項第八号に規定するツール」の役務通達の解釈では「半導体素子、集積回路若しくは半導体物資の製造用の装置を含む。」と規定しています。</p>	<p>ご理解のとおり「ツール」には、集積回路の製造工程で使用されるもの(フォトレジスト等)も含まれます。</p>

No.	政令項番	質 問	回 答
	項第八号	上記の「含む」という書きぶりによれば、当該ツールには、前述の装置以外の貨物も含まれると存じます。 当該ツールには、集積回路の製造工程の中で使用される、フォトレジスト、マスクブランクス、フォトマスク及びペリクルも含まれるという認識でよろしいでしょうか？	
7	【8項：貨物】 貨物等省令第7条第六号	1. 光ファイバー結合型量子光源（スキューズド光源）も含まれるのでしょうか。 2. （1.に関連しますが）量子計算機のうち、どこからどこまでが規制対象なのでしょうか。	貨物等省令第7条第六号には、「量子計算機又はその電子組立品若しくは部分品」と規定されており、光ファイバー結合型量子光源が部分品となるか否かを、個別にご判断ください。
8	【8項：貨物】 貨物等省令第7条第六号	レンズ、光ファイバーなどのレベルの部品であっても、今回追加された「量子計算機」の内容に該当するのでしょうか。	貨物等省令第7条第6号ロ又はハに規定する組立品・部分品が対象となりますので、これに該当しないものは対象外です。
9	「電子組立品」 「組立品」 「モジュール」	今回の改正で「送受信モジュール」及び「送信モジュール」の解釈の「電子装置」が「電子組立品」に改正されました。 「送受信モジュール：信号の送受信のために双方向の振幅及び位相制御を行うことができる機多能電子組立品をいう。」 「送信モジュール：信号の送信のために振幅及び位相制御を行うことができる電子組立品をいう。」 「モジュール」、「電子組立品」はそれぞれ以下のように解釈が示されており、違いの一つとして分解の可否があると理解しております。 「モジュール：基板上に回路素子、個別部品又は集積回路を相互に接続したものであって、一体として交換可能であり、かつ、分解することが不可能なものをいう。」 「電子組立品：複数の回路素子、個別部品又は集積回路等の電子部品を特定の機能を行うように相互に接続したものであって、一体として交換可能であり、かつ、分解することが可能なものをいう。」 「送受信モジュール」及び「送信モジュール」は分解可能なものを指すのでし	「送信（送受信）モジュール」は、「～（多機能）電子組立品をいう。」と明確化したことから、「分解可能なもの」を指すと考えます。

No.	政令項番	質 問	回 答
		か、分解不可能なものを指すのでしょうか。ご教授いただけないのでしょうか。	
10	「電子組立品」 「組立品」	<p>今回の改正で「電子組立品」解釈が追加されましたが、これは解釈の文言上からもWAの“Electronic assembly”に相当するものと理解しています。</p> <p>一方で、WAには存在しない「組立品」解釈が7の項には残っており、「電子組立品」とほとんど同じ解釈文言となっております。</p> <p>両者の違いは何でしょうか。混乱を招く恐れがあると考えます。</p> <p>「組立品」は一般的な言葉と思います。2項、3項、4項、10項、13項で「組立品」を含む条文がありますが、これらの項番では「組立品」の解釈はありません。</p> <p>また、電子計算機の中に「電子組立品」がありますが、電子計算機は必ずしも計算部分のみでできているわけではなく、外部とのインターフェース等もあります。様々な構成単位がある中で、電子部品を組み立てたものを「電子組立品」と呼んでいると推測します。</p> <p>また、マイクロ波用に部品を組み立てたものは「マイクロ波組立品」と呼ばれるように、何らかの目的の元に部品を組み合わせたものを「〇〇組立品」としており、その形態や目的によって、「マイクロ波組立品」「電子組立品」と呼んでいると推測します。</p> <p>7の項に限って「組立品」を定義する理由は何でしょうか。</p>	<p>ご理解のとおり、パブコメのCISTEC意見を踏まえて、“Electronic assembly”に対応する規定を反映したものです。</p> <p>また、改正後においても「組立品」という用語が規定されているため、これまでの解釈として存置したものです。</p>
11	「電子組立品」 「組立品」 「モジュール」	<p>「電子組立品」「組立品」と似て非なるものとして、「モジュール」の定義がありません。</p> <p>「モジュール」の定義は古くはなじみのない言葉だったと理解しており、平成4年の法令集に現在と同様の定義があります。</p> <p>しかし、モジュールは英文では“module”であると推測しますが、WAには定義はありません。</p> <p>また、質問上記3に記した疑問がでてきます。</p> <p>「モジュール」を7の項で定義する必要性は何でしょうか。</p>	<p>WAに定義がない用語であっても解釈を措置する場合もあり、明確化のために措置されたものであると考えますが、必要性については今後の検討といたします。</p>
12	「電子組立品」 「組立品」	<p>6項において新たに「電子組立品」の用語が追加され、7項において「組立品」の用語が追加されていますが、今回の改正説明の資料を見ても他の改正のような説明がなく、背景や意図がわからない状況のため、説明をお願いいたします。</p>	<p>No.10の回答を参照ください。</p>

No.	政令項番	質 問	回 答
13	「電子組立品」 「組立品」	「輸出貿易管理令の運用について」の改正で、いくつかの項番における解釈につき、『組立品』が『電子組立品』に変わったが、この背景を教えてください。今まで本規制において何が不十分であり、具体的にどのような貨物を規制すべく改正するのでしょうか。	No.10 の回答を参照ください。
14	「電子組立品」 「組立品」	輸出管理対象品目の追加と半導体製造装置の閾値等の見直しについて説明がありましたが、従来の「組立品」が「組立品」と「電子組立品」の解釈に分かれることについての説明がありませんでした。該非判定に影響を及ぼすものではないと解釈して良いのでしょうか？	それぞれ改正後の用語の解釈により、該非判定をお願いします。